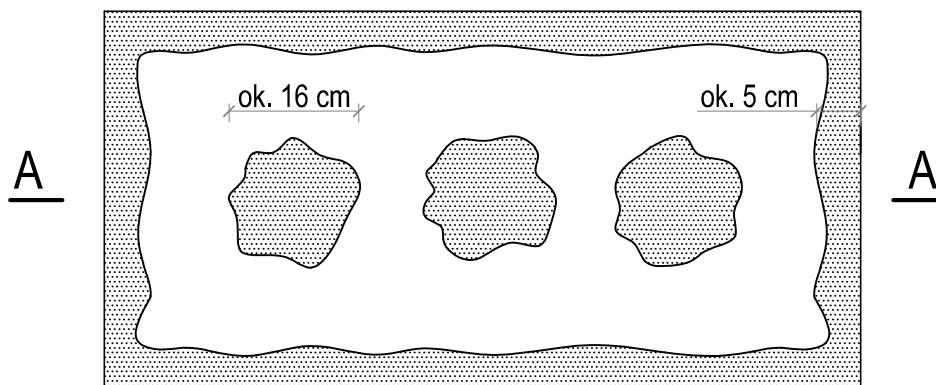
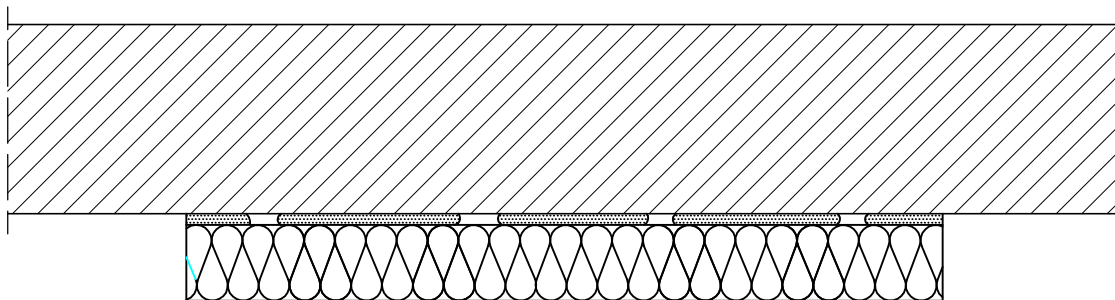
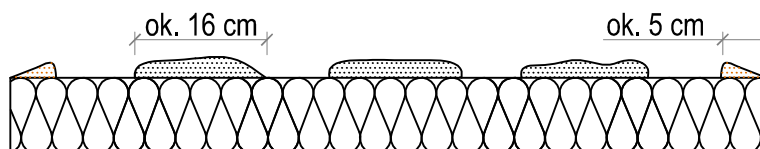




przekrój A - A



$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% / 40 \%$$

- Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia płyty termoizolacyjnej do podłoża
P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej przylegająca do ściany

UWAGI:

Do klejenia izolacji termicznej używa się zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). Zaprawę klejową należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody obwodowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

ZADANIE:			
Budowa świetlicy wiejskiej w Pcinie			
INWESTOR:			
Gmina Ciepiałów ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów			
LOKALIZACJA:			
dz. nr ew.51/1 obręb 0022 Pcin			
TYTUŁ RYSUNKU:			
Klejenie płyt izolacji termicznej.			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ:			
OPRACOWAŁ:			
STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
PROJEKT TECHNICZNY	12.2025r.	-	A.12